

無電解Ni・Pd・Auめっき

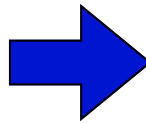
要旨

電解めっき特有のデメリットに対し、無電解の貴金属めっきのニーズが高まっております。
電解Auめっきを多く取り扱う弊社では、ニーズにお応えすべく無電解Ni・Au・Pdめっき工法を確立いたしました。

電解めっきのデメリットは無電解で解決

<電解めっきのデメリット>

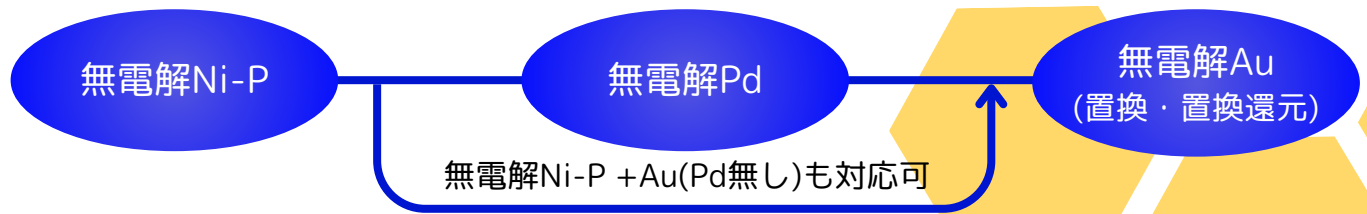
- 通電用の接点エリアの設定が必要
- 接点箇所が未着になる
- 導通が必要(不要箇所をめっきが必要)
- 膜厚のばらつき(材料費UP・性能不安定)
- 通電確保のため、ダミーが必要



<無電解めっきのメリット>

- 接点不要
- 接点確保による未着無し
- 導通不要(金属部分のみめっきが析出)
- 膜厚が均一、性能が安定化
- ダミー不要(材料費削減)

めっき仕様



特徴と膜厚

	無電解Ni-P	無電解Pd	無電解Au
特徴	鉛フリータイプ	耐熱による下地Ni層の拡散防止(バリア層)	WB性・はんだ接合性が良好 ※半導体部品に適したAuめっきです
膜厚	0.5~10 $\mu\text{m} + \alpha$	0.05~0.4 μm	~0.1 μm (置換Au) 0.1~0.5 μm (置換還元Au)

対象物

- 製品事例 : 各種基板/接点部品/ガラスハーメ品/複合部品 等
 対象物の材質 : Cu系/Fe系/SUS系/アルミ/Mo/W/Ti/メタライズ(スパッタ・ロウ付け品)等
 独自技術 : 弊社固有のめっき技術で、アルミ、SUS、難素材(Mo・W等)を下地めっきすることが可能



~ 不可能への挑戦 ~
 株式会社 友電舎
 大阪市此花区常吉2-4-8
 TEL : 06-6465-1663
 e-mail : info@ydn.co.jp
 URL : http://www.ydn.co.jp